



郵便はがき



株主通信

第24期上半期

自2025年4月1日 至2025年9月30日



株式会社ジードット <証券コード：3841>

当冊子に関するお問合せ先

株式会社ジードット 経営管理本部
東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲 Tel：03-6262-8400（代）
E-mail：corporate.planning1@jedat.co.jp

中面にお知らせがあります。万一ぬれている場合はよく乾かしてからご覧ください。

フォトマスク静電破壊検証のリリース

ジードットは、2025年6月末リリースのSX-Meister PowerVolt(V19.0)で、フォトマスクの静電破壊検証を新たにリリースしました。フォトマスクメーカーからの要望に対して、フォトマスクの静電破壊リスクを検証する解析モデルを開発し、この解析モデルとPowerVoltのベースとなる「高精度な抵抗抽出機能」「論理演算・デバイス定義機能」「直流解析機能」を組み合わせることで、マスク製造前にCADデータ上でフォトマスクの静電破壊のリスク検証を世界で初めて実現しました。これにより、製造コストのロスを大幅に削減でき、品質の向上に大きく貢献します。

株式数及び株主数 (2025年9月30日現在)

発行可能株式総数	7,800,000 株
発行済株式総数	3,909,800 株
株主数	1,551 名

株主メモ

上場市場	東京証券取引所 スタンダード市場
事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
配当基準日	3月31日
株式の売買単位	100株
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
事務取扱場所	みずほ信託銀行株式会社
公告掲載方法	電子公告とし、次の当社ホームページに掲載します。 https://www.jedat.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載します。

会社概要 (2025年9月30日現在)

商号	株式会社ジードット (Jedat Inc.)
所在地	〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲
代表者	代表取締役 松尾 和利
営業開始	2004年2月2日
資本金	762,524,260 円
事業内容	電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等設計支援のためのソフトウェア開発・販売及びコンサルテーション

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。2026年3月期上半期の業績をご送付申し上げます。

当中間会計期間における売上高は10億26百万円（前年同中間期比6.0%増）となり、増収となりました。営業利益も人件費の増加はあるものの、売上増による粗利増により1億2百万円（前年同中間期比17.1%増）と増加しました。経常利益は、円高による為替差損等の影響により、1億円（前年同中間期比6.9%増）となり、中間純利益は、75百万円（前年同中間期比15.7%増）となり、増収増益となりました。

当中間会計期間におきまして、当社の主要顧客である半導体を含む電子部品業界では、前年度・第1四半期に引き続きAI関連分野は堅調に推移したものの、スマートフォン、パソコン、産業機械向けの半導体デバイスについては低迷が続く、二極化の様相を呈しております。また、アメリカのトランプ政権による関税政策の影響について、今後不透明感や景気減速感が表面化してくることが予想されており、世界経済にマイナスの影響を与えることが想定されます。

このような状況の中、当社は産官学との協力を強化し、2025年4月1日に有明工業高等専門学校が開設しましたCircuit Design and Education Center (CDEC) に教育利用を目的としたSX-Meisterのライセンスを提供しLSI設計の人材育成に貢献しております。また、アナログ半導体向けにAIを用いた設計の自動化に取り組み、設計環境の効率化を追求しており、2025年6月末には、フォトマスクの静電破壊検証の技術を実装した「SX-Meister PowerVolt(V19.0)」をリリースしました。この「SX-Meister PowerVolt(V19.0)」の機能追加により、マスク製造前にCADデータ上でフォトマスクの静電破壊のリスク検証を世界で初めて実現しました。これにより、製造コストのロスを大幅に削減でき、品質向上に大きく貢献することが期待できます。さらに、7月には、X-FAB社（本社：ベルギー）の協力の下、同社が提供するXO035-stdformats-IPDKをSX-Meister上で快適に利用するための環境（Wrapper）を構築しました。これにより、SX-MeisterでX-FAB社の製造ルールを保証した設計が行えるようになり、製造までの時間短縮と市場投入の加速が実現できます。国内の販売促進活動においては、2025年4月に開催された「Photomask Japan 2025」や8月に開催された「DVCon Japan 2025」に、当社主力製品や各パートナー企業の代理販売製品を出展し、多くの来場顧客に製品紹介を行うことができ、新規の商談開拓につながりつつあります。デバイス設計受託サービスにおいては、顧客開拓活動を積極的に実施した結果、順調に業績に貢献しました。

当下半期に置きましても、引き続き主力製品の更なる機能強化と販促活動の強化に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、どうかよろしくお願い申し上げます。

代表取締役 社長執行役員

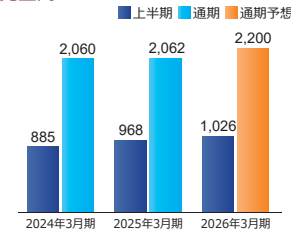
松尾和利

中間会計期間 売上高 （単位:百万円）

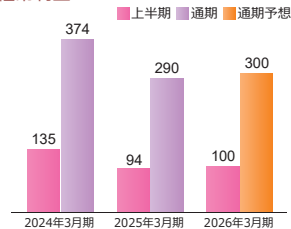
		2025年 3月期	2026年3月期		
		実績	期初計画	実績	前年同期比
事業別 売上高	製品	517	589	608	+ 17.6%
	サービス	205	213	216	+ 4.9%
	ソリューション	245	198	202	△ 17.6%
市場別 売上高	半導体市場	747	760	791	+ 5.9%
	FPD市場	221	240	235	+ 6.2%
製品区分別 売上高	自社開発製品	771	710	724	△ 6.1%
	代理販売製品	197	290	302	+ 52.9%
売上高合計		968	1,000	1,026	+6.0%

財務ハイライト （単位:百万円）

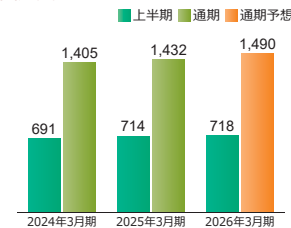
売上高



経常利益



固定費



総資産・自己資本

